

DM 158NN 围坝材料 产品技术数据表

卓越的温度循环性能
优异的机械冲击性能
高良率

简介

DM 158NN 是一款非流动型、低温快速固化、高纯度液态环氧封装材料，可形成极薄且高度精确的围坝结构。该材料适用于倒装芯片及晶圆级芯片尺寸封装应用，同时也适合用于多种先进封装形式中的裸芯片保护，包括存储卡、芯片载体、混合电路及多芯片模块 (MCM) 等。DM 158NN 专为高产能制造环境而设计，在制程速度、抗机械冲击能力及高可靠性方面表现出色。材料具备良好的点胶性能，可有效降低内应力引入，并提供卓越的可靠性表现 (如优异的温度循环性能) 及出色的机械强度与抗冲击能力。

物理特性

产品名称	DM 158NN 围坝材料
外观	黑色
未固化材料性能	
專案	數值
比重 (ASTM D1475-60)	2.5 g/cm ³
粘度(Brookfield, 0.5 rpm)	280 – 600 kcP
固化后材料性能	
剪切强度	2,600 psi

玻璃化转变温度(Tg) (ASTM D3418-82)	156 °C
C.T. E(ASTM E831) PPM /°C	$\alpha_1 = 22$; $\alpha_2 = 71$
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过

推荐固化条件

150 °C 固化 30 – 60 分钟

说明：可根据客户需求提供其他可选固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下，于原密封包装中储存，保质期为 6 个月。超过该期限储存可能导致材料粘度升高。请防止材料受潮、挥发或混入异物，否则可能对其加工性能产生不利影响。

安全信息

DM 158NN 为环保型、低毒性材料。在操作和使用过程中仍建议遵循常规工业卫生与安全规范。详细安全信息请参阅产品 安全数据表。

包装规格

DM 158NN 系列阻尼材料提供 10 cc 和 30 cc 兩種規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息，請聯繫 YINCAE 公司。